

令和8年5月20日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会
会長 嶋田 勇三

奥野製薬工業見学講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会では、定例講演会とは別に、見学講演会を企画しました。今回は、奥野製薬工業で開催します。

ご多忙の中恐縮でございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同見学講演会の情報を配信します。

敬具

記

- 開催日時：令和8年7月3日（金）見学講演会 13：00～17：00
技術交流会 17：00～19：00
※集合時間 12：00～12：45
- 開催場所：奥野製薬工業（株）放出工場（大阪市鶴見区放出東1丁目10番25号：JR放出駅から徒歩約10分：<https://www.okuno.co.jp/company/access.html>）
※現地集合・現地解散

3. プログラム：“奥野製薬工業見学講演会”

13:00～14:00 プログラムテーマ①	『奥野製薬工業の会社紹介と技術紹介』 奥野製薬工業（株）基板・半導体領域長 吉川 純二 氏 講演内容：先端半導体パッケージ向けガラス基板用無電解銅シードおよびスルーホールフイリング用電解銅添加剤
14:00～15:30 研究棟／製造工場見学	『見学』：研究棟および製造工場「iCUBE」 研究棟では以下の見学を行う。 <ul style="list-style-type: none">プリント配線板・半導体ウェハ/パッケージ基板基板に使用する無電解銅めっき・電解銅めっき薬品研究開発プラスチックめっきに使用する前処理薬品およびめっき薬品研究開発アルミニウム用、陽極酸化の各種処理薬品研究開発金属用無電解Niめっき研究開発多種測定・分析装置ラボラインによる簡易的なめっきランニング試験 環境配慮型次世代工場である「iCUBE」は、半導体分野などエレクトロニクスに関する表面処理薬品の供給体制を強化するために建設され、CN（カーボンニュートラル）・GX（グリーントランスフォーメーション）とDX（デジタルトランスフォーメーション）の両立を実現している。本見学では、1Fの充填・梱包・積込みラインの見学、2Fの見学エリアからの工場見学に加え、大型モニターでiCUBEや製造工程の工場説明やビデオ鑑賞を行う。
15:30～15:50	－ 休 憩 －
15:50～17:00 プログラムテーマ②	『講演：車載からPhysical AIへ向かう半導体パッケージ技術』 大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所（産研）所長・特任教授 菅沼 克昭 氏 講演内容：自動車の自動運転からロボット、製造支援、ドローン・航空機、医療の全てに渡って、自律的に制御する時代がやってくようとしている。その土台となるのが、AIを担う先端半導体であり、同時にパワー供給のためのパワー半導体である。自律的に動くことを支えるためには、AIパフォーマンスと同時に壊れないこと、省エネルギーであること、更には広く普及を妨げないコストが最適化されていることがある。パッケージ技術はその基本を支え、特に日本が世界を先導するべき自動車の産業で見本を見せることが望まれる。本講演では、データセンターと配線を隔するエッジの世界を切り開くパッケージ技術の動向を紹介する。
17：00～19：00	『技術交流会』 参加者の皆様と意見交換、ネットワーキング

4. 参加費：会 員：10000 円／人（不課税）
会員外：22000 円／人（不課税）
（参加費には技術交流会が含まれており，当日会場にて現金でお支払いいただきます）

5. 参加申し込み：

会 員：会員はメールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mailにてお申し込みいただけますようお願いします。本見学会は会員も参加費が必要です。

会員外：ホームページのお問い合わせフォーム (<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>) より「お問い合わせ内容」の項目に「7月3日奥野製薬工業見学講演会参加希望」とご記載下さい。参加申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前と E-mail アドレスもご記入ください。お申し込み後、折り返しご連絡をいたします。

申込締切日：令和 8 年 6 月 10 日（水）

※定員に達し次第，締め切ります。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会 事務局

URL：<http://www.j-jisso.org> (HP 右上の「お問い合わせ」からご連絡下さい)